

# 柏騰科技 (3518)

## 法人說明會

日期：2024 / 12 / 02

# 免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之預測性資訊，包括營運展望、財務狀況及業務預測等內容，係本公司基於內部資料及外部整體經濟發展現況所得之資訊。
- 本公司未來實際產生的營運結果、財務狀況與業務成果，可能與預測性資訊有所差異，其原因可能來自各種因素，包括但不限於市場需求、各種政策法令與整體經濟現況之改變，以及其他本公司無法掌控之風險等因素。
- 本簡報中所提供之資訊，係反應本公司截至目前為止對於未來的看法，並未明示或暗示性地表達或保證其具有正確性、完整性或可靠性。對於簡報內容，未來若有任何變更或調整，本公司不負責更新或修正。

# 大綱

## CONTENTS

01

公司簡介 Company Overview

02

財務資訊 Financial Information

03

SiC產品營運說明  
progress report For SiC factory

04

營運展望  
Operating status

05

資訊交流 Q&A



# 公司簡介



## 柏騰科技(3518)

柏騰科技 (台灣證券交易所 | 股票代號3518) 成立1995年，為全球首家將真空濺鍍薄膜技術應用在3C產品的EMI/ESD解決方案，也為台灣證券交易所首家真空濺鍍技術公司。

- ◆ 成立時間：84.10.20
- ◆ 資本額：96,042萬元
- ◆ 董事長：黃逸駿
- ◆ 總經理：游秀屏
- ◆ 目前主要產品及其應用：  
PVD鍍膜－佔比 95%  
其他－佔比 5%

# 關於柏騰



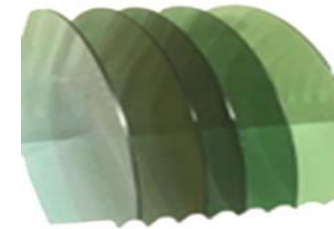
## 柏騰臺灣總部 技術開發

- 成立時間：1995年
- 資本額：9億6仟萬



## EMI電磁波防護鍍膜& 外觀鍍膜產品

- 南京廠/內江廠 (PVD鍍膜&設備)
- 全球NB品牌，塑膠機殼EMI供應商龍頭
- 市占率50%，出貨約5,000萬件/年



## 碳化矽(SiC)晶圓

- 南崁廠(2023.1)
- 嘉義廠(建置中)
- 6~8吋碳化矽(SiC)晶圓

# 發展歷程

柏騰為全球首家將真空濺鍍薄膜技術應用在3C產品的EMI/ESD解決方案，目前為NB防EMI最大供應商，市佔率約50%，為業界少數具備EMI製造、PVD設備及製程設計能力。2022年併購晶成材料擁有SiC(碳化矽)基板生產技術並進入第三代半導體供應鏈，2024年於嘉義建置首座8吋SiC基板廠。





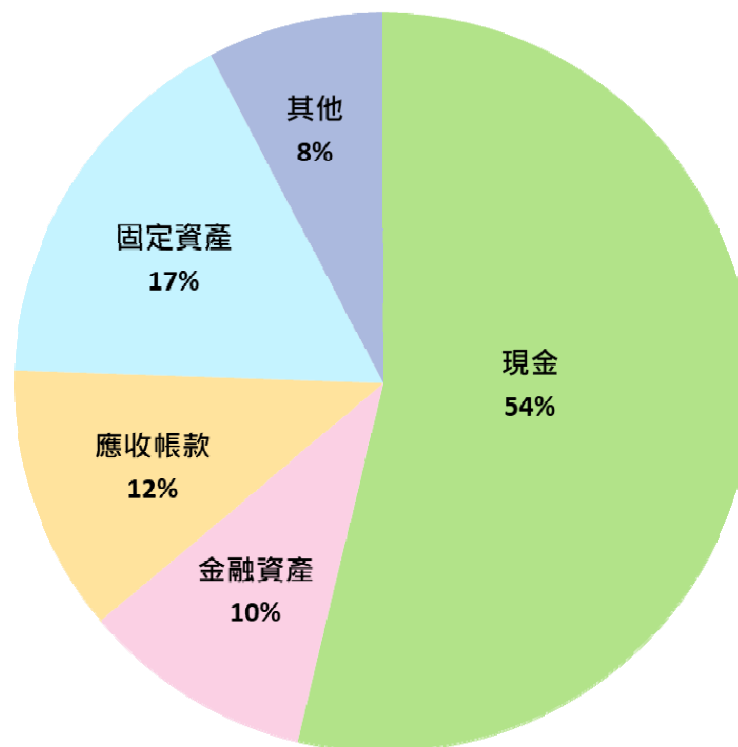
# 財務資訊

# 2024年第三季合併資產負債表

單位:新台幣佰萬元

|             | 2024.9.30 | %   | 2023.12.31 | %   | 2023.09.30 | %   |
|-------------|-----------|-----|------------|-----|------------|-----|
| 現金及約當現金     | 1,212     | 54  | 801        | 51  | 508        | 30  |
| 金融資產-流動&非流動 | 228       | 10  | 58         | 4   | 445        | 27  |
| 應收帳款及票據     | 265       | 12  | 279        | 18  | 294        | 18  |
| 存貨          | 19        | 1   | 22         | 1   | 7          | 0   |
| 待出售非流動資產    | 10        | 0   | 0          | 0   | 0          | 0   |
| 固定資產及使用權資產  | 378       | 18  | 314        | 20  | 312        | 19  |
| 其他資產        | 145       | 6   | 87         | 6   | 111        | 6   |
| 資產總計        | 2,257     | 100 | 1,561      | 100 | 1,678      | 100 |
| 短期及一年內到期借款  | 211       | 9   | 194        | 12  | 184        | 11  |
| 其他應付款       | 76        | 3   | 72         | 5   | 73         | 4   |
| 應付公司債       | 283       | 13  | 0          | 0   | 0          | 0   |
| 長期借款        | 31        | 1   | 5          | 0   | 6          | 0   |
| 其他負債        | 156       | 7   | 64         | 4   | 78         | 5   |
| 負債總計        | 756       | 34  | 336        | 21  | 340        | 20  |
| 權益總計        | 1,501     | 66  | 1,226      | 79  | 1,338      | 80  |
| 每股淨值        | 15.48     |     | 14.59      |     | 15.28      |     |

# 財務結構與比率



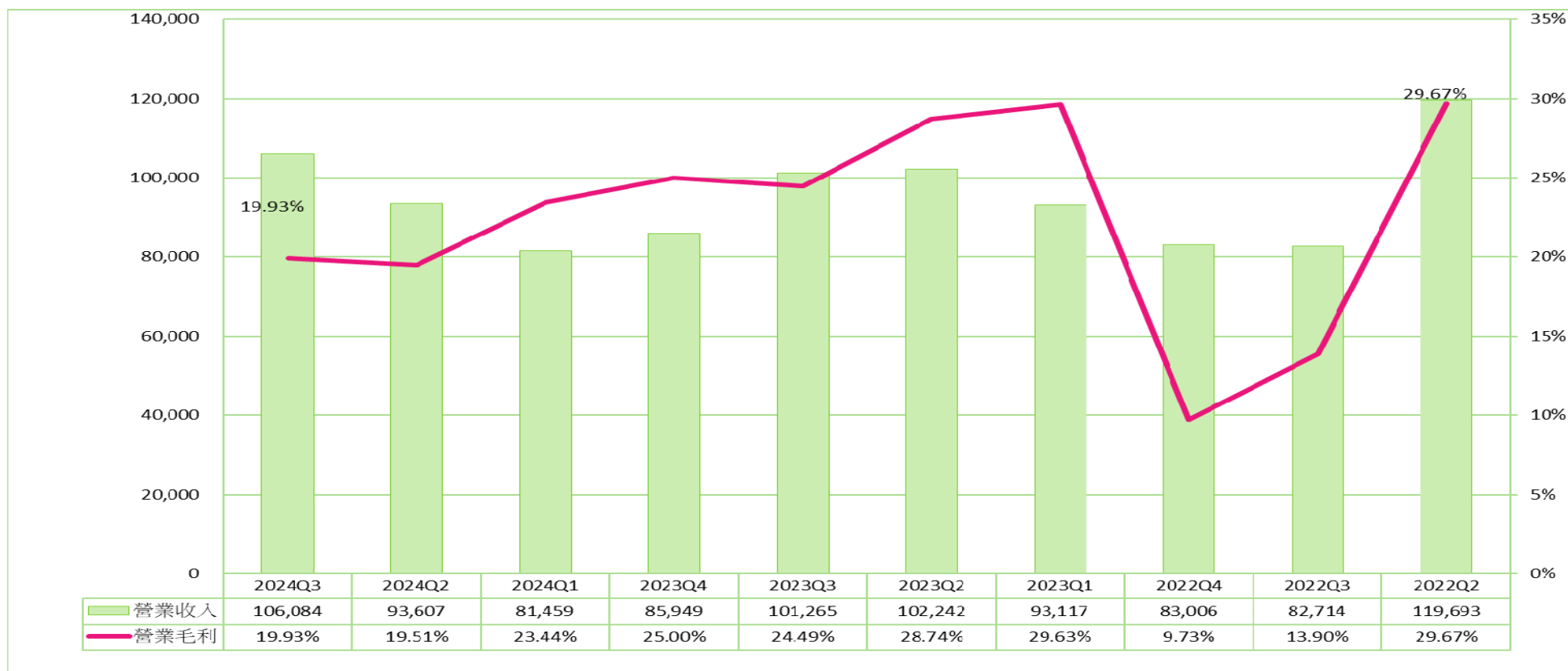
| 項 目    | 2024年Q3 | 2023年   | 2022年  | 2021年  | 2020年  |
|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 負債比率   | 33.51   | 21.49   | 16.30  | 24.54  | 37.12  |
| 流動比率   | 549.97  | 395.27  | 606.50 | 377.86 | 185.25 |
| 現金流量比率 | (29.64) | (17.17) | 63.32  | 31.54  | (1.05) |

# 2024年第三季合併綜合損益表

單位:新台幣佰萬元

| 項目            | 2024年第三季 | 2024年第二季 | 增減%   | 2023年第三季 | 增減%   |
|---------------|----------|----------|-------|----------|-------|
| 營業收入          | 93       | 94       | (1)   | 96       | (3)   |
| 營業毛利          | 12       | 18       | (33)  | 27       | (54)  |
| 營業費用          | 69       | 51       | 36    | 38       | 83    |
| 營業淨利(損)       | (57)     | (33)     | (75)  | (11)     | (418) |
| 營業外收支         | (4)      | 3        | (233) | 2        | (285) |
| 繼續營業單位稅前淨利    | (61)     | (30)     | (106) | (9)      | (588) |
| 所得稅費用         | 2        | 16       | (89)  | 1        | (52)  |
| 繼續營業單位本期淨利(損) | (63)     | (46)     | (38)  | (10)     | (526) |
| 停業單位損失        | (1)      | 0        | 0     | (4)      | 67    |
| 本期淨損          | (64)     | (46)     | (41)  | (14)     | (349) |
| 毛利率 ( % )     | 13       | 20       |       | 28       |       |
| 純益率 ( % )     | (69)     | ( 49 )   |       | (15)     |       |
| 每股盈餘 ( 元 )    | (0.68)   | (0.55)   |       | (0.18)   |       |

# 收入與毛利率趨勢圖



# 2024年第三季合併現金流量表

單位:新台幣佰萬元

|                 | 2024年1月1日<br>至9月30日 | 2023年1月1日<br>至9月30日 |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| 營業活動之淨現金流入(出)   | (96)                | (43)                |
| 投資活動之淨現金流入(出)   | (226)               | (282)               |
| 籌資活動之淨現金流入(出)   | 692                 | (57)                |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 40                  | 5                   |
| 本期現金及約當現金增(減)數  | 411                 | (378)               |
| 期初現金及約當現金餘額     | 801                 | 886                 |
| 期末現金及約當現金餘額     | \$1,212             | \$508               |

# 113年重要事件說明

- ◆ 出售其子公司柏霆(蘇州)光電科技有限公司100%股權(113.09.18)
- ◆ 大陸子公司浙江駿昇光電科技有限公司辦理清算(113.09.18)
- ◆ 113年國內第一次有擔保可轉換公司債收足債款。(113.8.13)
- ◆ 董事會通過現金增資子公司晶成材料新台幣6億元。(113.8.09)
- ◆ 通過子公司晶成SiC新廠生產設備採購新台幣2.7億元。(113.8.09)
- ◆ 113年現金增資收足股款暨增資基準日。(113.7.10)
- ◆ 股東常會改選7席董事，董事會一致推舉黃逸駿先生擔任董事長。(113.6.18)
- ◆ 董事會通過辦理113年現金增資及發行113年國內第一次有擔保可轉換公司債(113.3.13)
- ◆ 本公司登記地址遷至「桃園市蘆竹區南山路一段108巷2號」(113.01.25)
- ◆ 通過子公司晶成SiC新廠生產設備採購新台幣1.6億元。(113.01.25)

詳情請參閱柏騰公司網站 (<https://www.pttech.com.tw>) 最新消息公告及公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>) 重大訊息公告。



# SiC 新廠進度報告

progress report For advanced SiC factory

# SiC新廠投資計劃

- ◆ 建廠預算：新台幣 89,953 萬元(一期)
- ◆ 新廠位置：嘉義大埔美智慧型工業園區
- ◆ 主要產品：8吋SiC晶圓
- ◆ 一期產能：3000PCS/月 / 50 台長晶爐
- ◆ 最大產能：6000pcs/月/100 台長晶爐

## 2024H2 (建置期)

ISO9001及14001認證  
通過目標客戶認證  
開始建置新廠廠務及工程  
導入先進8吋長晶製程設備，縮短製程開發時間

## 2025 (新廠啟用)

Q1廠務工程完工驗收  
Q2設備move in完成  
Q3設備試量產準備  
Q4新廠正式啟動  
開發非車用產品  
年產能4000pcs

## 2026 (一階段)

IATF 16949認證  
通過目標車用客戶認證  
年產能24000pcs  
歐美目標客戶送樣  
開發高階功率產品

## 2027 (二階段)

通過歐美車用大廠認證  
進入品牌車廠供應鏈  
年產能36000pcs  
進行新廠二期擴產準備  
最大年產能72000PCS

# 8吋廠進度說明

新廠規劃  
100%

一期&二期廠務設計、設備選型及製程規劃，第一期月產2000片(2026年)，第二期月產6000片(2027年)。廠務段滿足一、二期擴產需求。

設備採購  
80%

設備完成採購金額新台幣33,528萬元，預計2025年Q2開始進廠，Q2進廠安裝20台8吋長晶爐，Q3加工產線試量產。  
8吋新式長晶爐較原6吋設備生產效率增加30%。

工程進度

廠務工程招標中，整體工程預計2025年6月前完工，設備陸續安裝試俾，預計2025年Q4正式運行。

產品驗證

ISO9001取得認證/ISO14001認證中  
6吋產品通過多家客戶驗證(台灣)  
8吋產品年底送客戶驗證(日本&台灣)



## 營運展望



# 營運展望

## EMI鍍膜產品

2025年全球筆電出貨預估將年增4.9%，Chromebook方面，受惠北美教育標案及新興市場需求推動，出貨成長動能將提升至8%；越南、泰國、印度、墨西哥生產線仍需時間完備，中國仍是全球筆電主要生產地，對EMI訂單影響趨緩。

## PVD鍍膜技術

真空濺鍍(PVD)鍍膜技術應用範圍相當廣泛，尤其為符合ESG及環保減碳的趨勢潮流下，將PVD鍍膜技術應用在功能鍍膜及外觀表面處理。

- (1)AF鍍膜-NB產品
- (2)類陽極鍍膜-NB、3C產品
- (3)功能鍍膜－電子元件、基板

## SiC晶圓產品

- (1)SiC 晶錠 ( Ingot )
- (2)SiC 基板(Wafer )
- (3)晶圓磊晶片( ( EPI Wafer )

8吋較6吋面積增加1.8倍，但報價約為6吋的2~3倍，成本增加低於1.8倍，將有更好的獲利能力。

## SiC晶圓加工服務

- (1)6~8吋 SiC晶圓加工
- (2)SiC再生晶圓(Reclaim)

新廠具備完整晶圓加工產線，加工月產能可達7200片，就近提供國內6吋及8吋長晶廠晶圓加工及磊晶廠 SiC 再生晶圓(Reclaim)服務。



# 資訊交流

Q&A



# TRUE PARTNER FOR A BRIGHTER FUTURE



發言人：劉明怡 財務處副總

電話：(03)212-8833

E-mail：mingi@pttech.com.tw.